

FINEPLACER® lambda 2

亚微米贴片机

光电器件组装的最终设备

- » 亚微米贴装精度
- » 优越的光学分辨率
- » 优越的性价比



多种键合技术
(胶粘、焊接、热压、超声)

通过触摸屏实现全进程访问和简
易可视化编程

纯手动或半自动配置版本可选

数据/多媒体记录和报告
生成功能

可控贴片压力范围广

可选的工艺模块实现个
性化配置

功能

单个程序即可实现多种键合工艺	实现新技术方法的真正灵活性
独特的 FINEPLACER® 工作原理	简单、精密的贴片。低维护设计保证最高的稳定性
采用固定分光镜的视觉对位系统 (VAS)	芯片与基板的精确视觉对准
高清的工艺过程观测	即时的可视化过程反馈，快速简单的过程质量确认
同步控制所有相关工艺参数	最优的过程控制和再现性
模块化机器平台允许在整个使用期内进行现场改造	快速方便地升级贴片平台，以满足新的应用和技术要求
工艺模块具有跨 Finetech 不同设备的高兼容性	可实现将认证的工艺参数在系统间传输
具有预定义参数的顺序控制	以正确的顺序排列所有流程步骤，形成直观且有指导性的工艺流程

效益

技术和方法

- » 烧结
- » 热压焊接
- » 热-/超声键合
- » 焊接/共晶焊接
- » 胶粘贴片

工艺

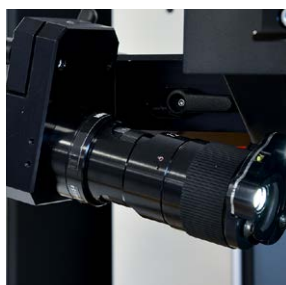
- » 倒装芯片键合 (正面朝下)
- » 高精度芯片键合 (正面朝上)
- » 2.5D及3D集成电路封装 (堆叠)
- » 芯片到玻璃基板贴装 (CoG)
- » 芯片到柔性基板贴装 (CoF)
- » 玻璃粘合

应用

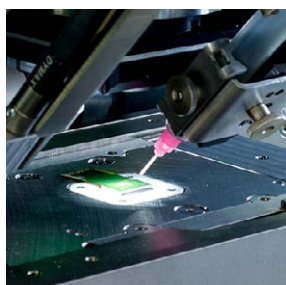
- » 激光二极管组装
- » 激光巴条组装
- » VCSEL/PD (阵列) 组装
- » 透镜 (阵列) 组件
- » 微型光学器件组装
- » 微型光具座组装
- » 光模块组装 (TOSA/ROSA)
- » 视觉图像传感器组装
- » μ LED (阵列) 组装
- » 通用MOEMS组装
- » 通用MEMS组装
- » 气压传感器组装
- » 加速度传感器组装

工艺模块 / 增强功能

- » 贴片力控制模块(自动)
- » 贴片力控制模块(手动)
- » 相机纵向移动模块
- » 芯片加热模块
- » 芯片陈放台
- » 芯片翻转模块
- » 点胶模块
- » 双摄像头光学系统
- » 甲酸模块
- » 对位符发生器
- » 贴片高度间隙调节模块
- » 高分辨率光学组件
- » 自动蘸胶模块
- » 工艺气体模块
- » 工艺气体选择
- » 工艺观察相机
- » 基板加热模块
- » 基板固定
- » 吸头更换模块
- » 超声模块
- » 紫外固化模块



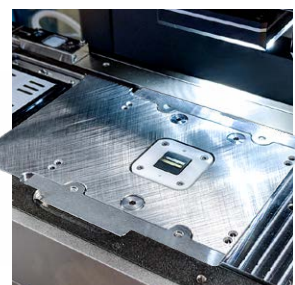
工艺观察相机



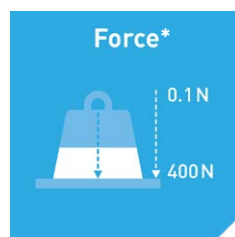
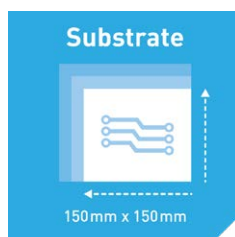
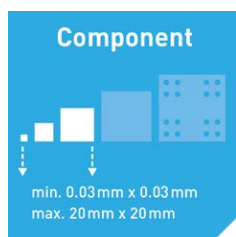
点胶模块



紫外固化模块



基板加热模块



研发到量产的无缝转换

你有多少前景乐观的产品创意在从研发到量产过程中夭折？你不能持续下去是因为你现有设备的技术限制还是不确定的投资回报？你是否在试图根据生产要求将原型制作工艺向自动化转换的过程中陷入困境？

Finetech“原型到量产”整体解决方案，保证了从研发到量产的1比1工艺转换，保持了完整的技术自由，实现了在短时间内打入市场的同时，将财务风险最小化。

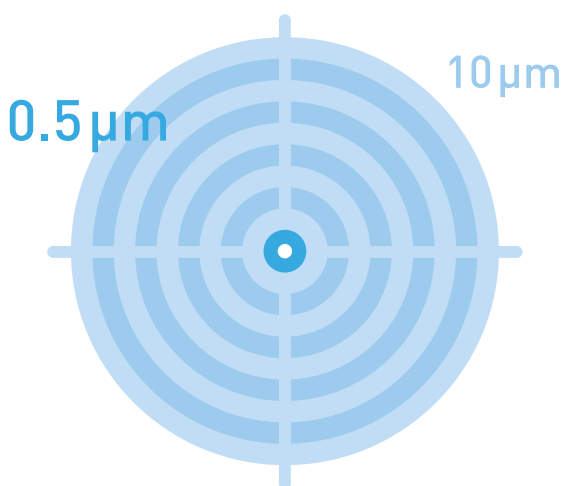
[在此下载本文:](#)



我们如何验证精度

关于封装行业中的组装系统，也就是所谓的贴片机，其贴装精度是分类的关键因素。然而，通常对这个精度是什么含义，又是如何进行验证不是十分明确。因此，Finetech 采用了一种透视可验证的方法来证明我们设备的贴片精度。这篇技术论文列举了影响设备精度的相关因素，如何让客户自己对Finetech设备的精度进行验证，此方法也同时适用于其它供应商的同类设备。

[在此下载本文:](#)



客户反馈

"We use the FINEPLACER® lambda 2 for development processes on MEMS, e.g. for precise dispensing and the placement of microstructures. The system fits in with the investment strategy at ISS, where flexible facilities with a wide range of materials enable research into new materials and, in particular, rapid prototyping."



Severin Schweiger
Fraunhofer IPMS, Integrated Silicon Systems